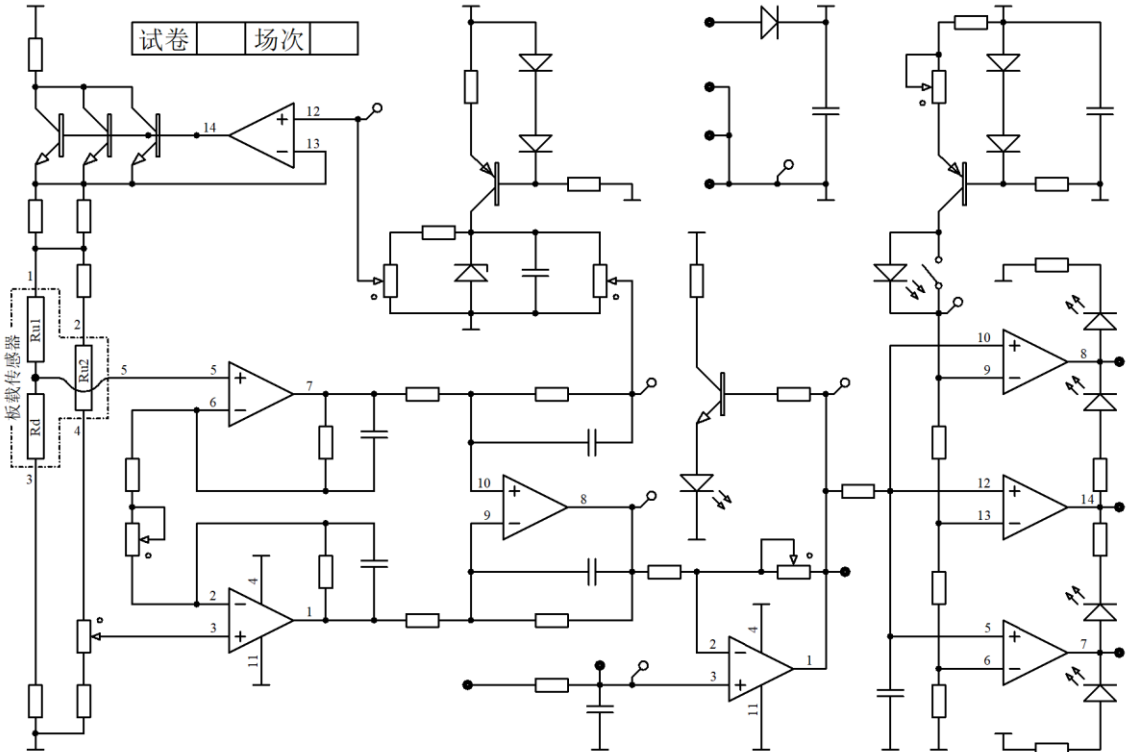


# 江苏省 2023 年中职职教高考

## 电子专业技能考试 技术公开信息说明

### 一、电子产品的电路原理参考图



### 二、说明

1. 套件包括 1 个内装元器件的材料袋、1 块厚度小于 1.6mm 的沉金工艺 PCB。按照试卷清单及装焊要求，参考装配图，对照 PCB 及元器件实物，合理安排装焊工序完成 PCB 的正、反面组装。上图为实际卷面中产品原理图的参考图，各场次装焊工艺要求、步骤及工作量完全相同，贴片焊点个数占比 55%；
2. 试卷清单中注明的 3 个元件暂不装焊，在实际应用电路调试前再有序装焊；
3. 板载传感器（雨水、称重功能共用）由 3 组 PCB 导线构成，导线所在 PCB 区域可局部形变。该板载传感器无需装焊或连线，禁止上锡。试卷第四项有传感器阻值检测条目，注意其检测提示和检测合格的描述；
4. 套件中有 6 个 3362P-1 型单圈电位器，注意不同规格及对应安装的位置，调试时注意调节方向；
5. 套件中的插件发光二极管和三极管要求悬空安装，底座平面距 PCB 安装面 3~4mm，顶部高度不超过直针贴板装焊后的顶部高度(约 8mm)；其余的元器件贴板装焊。各插件底部引脚垂直伸出 PCB 表面留 1~2.5mm 高度，集成电路、单排针贴板装焊后不必剪脚；
6. 套件中有 1 个卧式水泥电阻，额定功率为 5W。工作时最大功率小于 1W，且需要平整地紧贴 PCB，常规工艺不适用本产品。各场次统一装焊工艺要求是：在该电阻体字符面相邻的两个长方形侧平面中任选一侧与 PCB 表面接触装配，按 PCB 封装上箭头指示朝向摆放，使字符面朝外后再整形装配焊接。此工艺使得电阻体与 PCB 接触面积最大、字符面在产品外侧面，达到平稳支撑产品又方便识读电阻规格的目的；
7. 套件中外观相似的元件可按照数量或体积或标识区分，清点种类及数量无误并完成指定元件检测后有序装焊；未开始焊接前，材料有残缺的填错漏补料申请（含 PCB 中板载传感器的检测不合格）经核实后立即换发；开始焊接后需要更换材料的（不含 PCB），请及时填写损失补料申请；损坏、遗失材料换发在开考 30 分钟后开放，按经过核实、实际换发的元件个数扣分；
8. 试卷第七项到第九项的调试内容及配分与样卷略有差异，其中第七项配分为 15 分，第九项无波形记录；
9. 调试过程中，背面装配的 3528 封装的单色超高亮 LED 亮度较高时，不必直视，避免眩目！
10. 调试称重功能应用中，3 个并联插件三极管未做平衡，有个别温升较高的可能，不要碰触，避免烫伤！